

klej DO PŁYTEK HK 160 NA POWIERZCHNIE TRUDNE I MOCNO OBCIĄŻONE

Modyfikowany tworzywami sztucznymi, elastyczny, bardzo wydajny klej do układania płytek i płyt na podłogach w garażach, warsztatach, salonach samochodowych oraz pomieszczeniach handlowych

rozplwiny

na ogrzewanie podłogowe

wydłużony czas otwarty

do każdego formatu płytek

bardzo wysoka wytrzymałość i przyczepność do podłoża

mrozoodporny i wodoodporny

wydajny i łatwy w obróbce

do wewnątrz i na zewnątrz



ZASTOSOWANIE

Klej do płytek na powierzchnie trudne i mocno obciążone nadaje się do skutecznego przyklejania płytek podłogowych średniego i dużego formatu, o średniej i niskiej nasiąkliwości (glazura, terakota, klinkier, gres, cotto, cementowe, kamienne) na każde sztywne jak i wymagające (trudne) podłoża wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie nadaje się do przyklejania płytek wielkoformatowych wszędzie tam gdzie występują zmienne warunki termiczne, w miejscach mocno obciążonych jak hale fabryczne, budynki przemysłowe, duże magazyny, sklepy, domy towarowe, supermarkety, salony samochodowe jak również w obiektach mieszkalnych (kuchnie, łazienki, salony). Ponieważ klej wypełnia całą przestrzeń pod płytką eliminując powstawanie pod nią pustek powietrznych ma zastosowanie na ogrzewane podłogi. Można również stosować w renowacji starych podłóg metodą „płytką na płytkę”.

UWAGA

Ze względu na swoje szczególne właściwości (zwiększona rozplwiność) klej nie nadaje się na powierzchnie pionowe.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wypełnia całą przestrzeń pod płytką – eliminuje powstawanie pustek powietrznych i gromadzenie się w nich wody (zamarzająca woda powoduje odspajanie płytek).
- 100 % wypełnienie zapewnia całkowite podparcie płytkom bardzo dużych formatów co eliminuje możliwość ich pęknięcia, w skutek uderzenia lub nacisku.
- Zwiększona przyczepność – rzeczywista przyczepność do podłoża betonowego w normowych warunkach wynosi około 2,20 MPa (przyczepność wymagana przez normę ≥ 1 MPa).
- Grubość warstwy sklejania – od 10 do 20 mm – pozwala na przyklejanie płytek na podłożach o niewielkich nierównościach lub wykonanie niewielkiego spadku.
- Skrócony czas wiązania - umożliwia bardzo szybko obciążać i użytkować powierzchnie (fugowanie płytek już po upływie 6 godz. od ułożenia ich na posadce).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być równe, suche, czyste, nieprzemarznięte i nośne. Należy usunąć z niego tłuszcze, stare powłoki malarskie, nacieki cementowe, środki antyadhezyjne i inne luźne części. Beton, części betonowe oraz różnego rodzaju powierzchnie cementowe powinny mieć przynajmniej 28 dni. Przed klejeniem płytek na podłożach cementowych należy sprawdzić wilgotność zawartą w podłożu. Wilgotność powinna wynosić maksymalnie 2%, a na powierzchniach ogrzewanych 1,8%. Podłoża bardzo chłonne należy przed klejeniem płytek zagruntować gruntem Hafgrunt HG 1.

Przed klejeniem na stare okładziny ceramiczne metodą „płytką na płytkę” należy wcześniej (około 24 godz.) przespachlować powierzchnię Klej do płytek na powierzchnie trudne i mocno obciążone. W tym przypadku należy 1/3 wody zarobowej zastąpić gruntem Hafgrunt HG 1.

PRZYGOTOWANIE KLEJU

Klej do płytek na powierzchnie trudne i mocno obciążone miesza się z zimną, czystą wodą przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. Zawartość opakowania 25 kg wysypać do około 4,5 – 5,0 l wody. Miesza się tak długo, aż powstanie masa o jednorodnej konsystencji pozbawiona grudek. Po czasie dojrzewania wynoszącym przynajmniej 5 minut należy materiał jeszcze raz krótko zamieszać. Tak przygotowaną porcję kleju należy zużyć w ciągu około 1 godz. Stężony materiał nie może być ponownie zamieszany i obrabiany, gdyż nie osiągnie się końcowej trwałości.

NANOSZENIE KLEJU

Najpierw nanieść na podłoże cienką warstwę kontaktową przy użyciu gładkiej części pacy. Następnie pacą zębatą z przynajmniej 10-milimetrowymi ząbkami prostymi lub półokrągłymi równomiernie rozprowadzić zaprawę na powierzchni. Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów pacy zapewni, że po dociśnięciu płytki do podłoża, zaprawa pokryje całą powierzchnię spodu płytki.

KLEJENIE PŁYTEK

Przy układaniu płytek na Klej do płytek na powierzchnie trudne i mocno obciążone nie jest wymagane moczenie płytek. Podgrzewane jastrychy cementowe przed rozpoczęciem układania płytek muszą zostać odpowiednio ogrzane a następnie schłodzone. Przed klejeniem okładziny ceramicznej na podłożach z działającą instalacją grzewczą, należy ją wyłączyć na dobę przed rozpoczęciem prac. Ponownie włączyć dopiero po całkowitym związaniu zaprawy (min. 48 godzin) i stopniowo podwyższać temperaturę. Czas otwartego schnięcia dla kleju w warunkach normalnych (+23°C i 50% wilgotności) wynosi około 30 minut. W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć. Po dociśnięciu i ustawieniu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i wynosić 100%. Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac nie powinna być niższa niż +5°C.

FUGOWANIE

Fugowanie płytek na podłożu można rozpoczynać po stwardnieniu kleju, jednak nie wcześniej niż po 6 godzinach od przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową klej osiąga po upływie około 24 godzin.

ZUŻYCIE:

Przy gładkim podłożu:

Paca zębata: 10 mm = ok. 5,0 kg proszku/m²

12 mm = ok. 6,0 kg proszku/m²

OPAKOWANIE:

25 kg worek papierowy wzmocniony folią PE

42x25 kg = 1050kg na palecie

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia. Termin przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.

DANE TECHNICZNE

Wygląd	szary proszek
Gęstość nasypowa suchej mieszanki	ok. 1,6 g/cm ³
Proporcje mieszania (na 25 kg proszku)	4,5 – 5,0 l wody
Wartość pH	>11
Min. / max grubość kleju	10 mm / 20 mm
Czas dojrzewania*	min. 5 minut
Czas zachowania właściwości roboczych*	ok. 1 godz.
Czas otwartego schnięcia*	ok. 30 minut
Fugowanie na podłogach*	po ok. 6 godz.
Wchodzenie na posadzkę*	po 6 godz.
Pełne obciążenie (w zależności od temp.)*	po min. 12 godz.
Temperatura obróbki i temperatura podłoża	od +5°C do +30°C
Odporność na temperaturę	od -30°C do +90°C

*Wszystkie podane czasy odnoszą się do temperatury +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury i niższa wilgotność powietrza przyspieszają, a niższe temperatury i wyższa wilgotność powietrza opóźniają czas obróbki i przebieg wiązania.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wyrób spełnia wymagania normy PN-EN 12004:2008 dla kleju klasy: C – klej cementowy; 2 – klej o podwyższonych parametrach; F – klej szybkowiązący; E – klej o wydłużonym czasie otwartym; C2 FE

Deklaracja Zgodności WE nr 005.



HAFROX Sp. z o.o. S.K.A.
ul. J. Cygana 4, 45-131 Opole

PN-EN 12004:2008

KLEJ DO PŁYTEK NA POWIERZCHNIE TRUDNE I MOCNO OBCIĄŻONE

Przyczepność wczesna	≥ 0,5 N/mm ² po 6 h
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm ²
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm ²
Wydłużony czas otwarty: przyczepność	≥ 0,5 N/mm ² po 30 min.
Klasa reakcji na ogień	Klasa F

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt zawiera cement. W połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn alkaliczny. W związku z tym należy używać środków ochrony indywidualnej w postaci rękawic i okularów ochronnych. Szczegółowe informacje odnośnie bezpieczeństwa, zdrowia i właściwości niebezpiecznych materiału dostępne są w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, którą otrzymacie Państwo na życzenie. Utylizacja pustych opakowań leży po stronie końcowego użytkownika i powinna być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGI

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 23°C i 50% wilgotności powietrza. Opisane wyżej właściwości materiału oparte są na doświadczeniu i badaniach laboratoryjnych. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału. W przypadkach powierzchni wątpliwych należy wykonać testy zastosowania i dokładnie sprawdzić jakość próby lub zasięgnąć porady producenta. Producent zastrzega sobie prawo do technicznych zmian produktu.